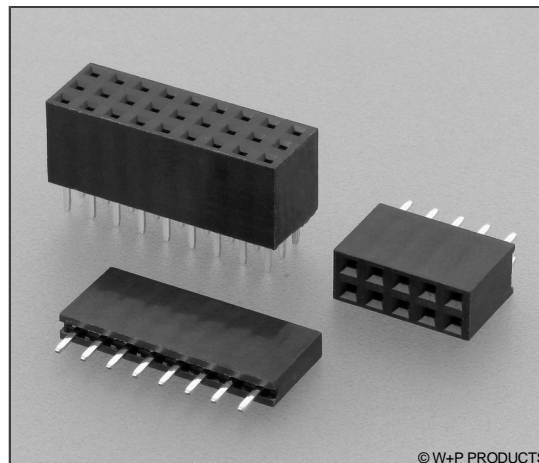


Buchsenleisten RM 2,54mm, gerade, 1-/2-/3-reihig – BH 8,5mm Female Headers, 2.54mm Pitch, Straight, 1/2/3 Rows – 8.5mm Profile

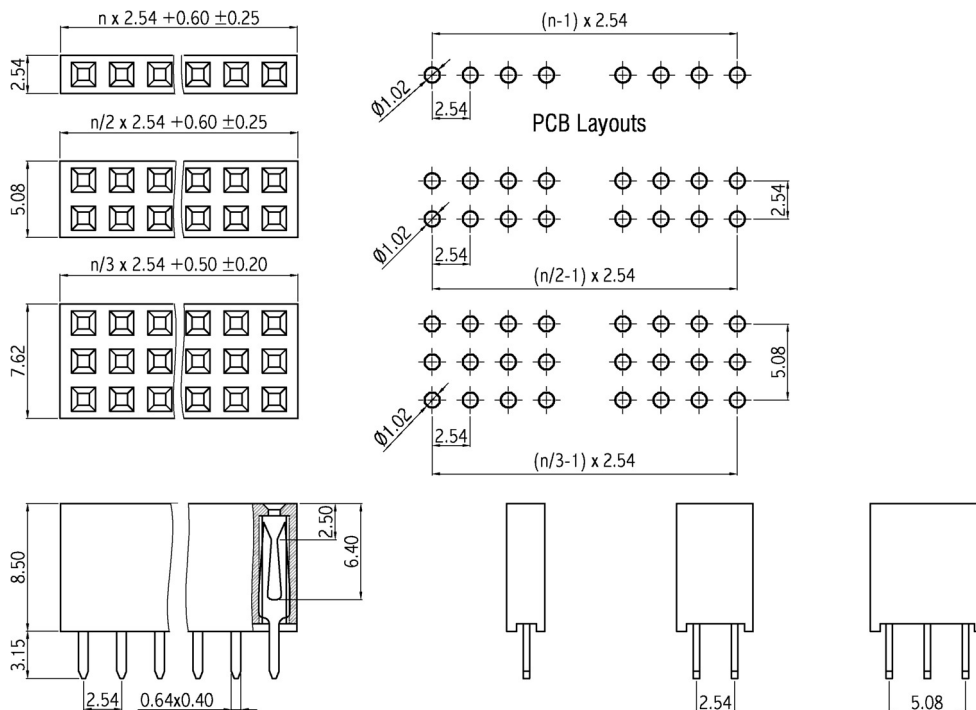
Technische Daten / Technical Data

| | |
|--|---|
| Isolierkörper <i>Insulator</i> | Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i> |
| Kontaktmaterial <i>Contact Material</i> | Kupferlegierung <i>Copper alloy</i> |
| Kontaktfläche <i>Contact Surface</i> | Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm) <i>Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)</i> |
| Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i> | < 20 mΩ |
| Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i> | > 1000 MΩ |
| Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i> | 500 V AC |
| Nennspannung <i>Voltage Rating</i> | 250 V AC |
| Nennstrom <i>Current Rating</i> | 3 A |
| Temperaturbereich <i>Temperature Range</i> | -40 °C ... +105 °C |
| Verarbeitung <i>Processing</i> | Wellen- oder Reflow-Lötverfahren <i>Wave or reflow soldering</i> |



© W+P PRODUCTS

Gabelkontakte für Vierkantstifte 0,635mm.
Fork contacts accept 0.635mm square pins.



Series

157

Contacts*

08

02-40 Einreihig
Single row
04-80 Zweireihig
Double row
09-96 Dreireihig
Triple row

Rows*

2

1 Einreihig
Single row
2 Zweireihig
Double row
3 Dreireihig
Triple row

Plating*

00

00 Vergoldet
Gold plated
50 Verzinnt
Tin plated
60 Sel. Au/Sn
Duplex plating

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Informationen zum Wellen-Lötverfahren

Wave Soldering Information

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.

Empfohlenes Wellenlötprofil:



Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

| Profileigenschaft | Kennwert |
|--------------------------------------|---------------|
| Temperatur Minimum T_{Smin} | 150 °C |
| Temperatur Maximum T_{Smax} | 200 °C |
| Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$ | 60 – 180s |
| Temperatur Lötbereich T_L | 217 °C |
| Verweildauer oberhalb T_L | 60 – 180s |
| Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$ | max. 3 °C / s |
| Höchsttemperatur T_P | 260±5 °C |
| Dauer Höchsttemperatur | 20 – 40s |
| Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$ | 6 °C / s |
| Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P | max. 8m |

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

| Profile Feature | Key Values |
|--------------------------------------|---------------|
| Minimum Temperature T_{Smin} | 150 °C |
| Maximum Temperatur T_{Smax} | 200 °C |
| Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$ | 60 – 180s |
| Soldering Range Temperature T_L | 217 °C |
| Duration above T_L | 60 – 180s |
| Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$ | max. 3 °C / s |
| Peak Temperature T_P | 260±5 °C |
| Duration Peak Temperature | 20 – 40s |
| Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$ | 6 °C / s |
| Duration 25°C - Peak Temp. T_P | max. 8min |

